



Communiqué de presse

Embedded World 2022

Stand de KIOXIA : 3A-117

KIOXIA est la première à présenter un dispositif de stockage amovible PCIe/NVMe conforme à la norme JEDEC XFM Ver.1.0

Le nouveau KIOXIA XFMEXPRESS XT2 est en cours d'échantillonnage



KIOXIA

Challenge Impossible Together with XFMEXPRESS™

Optimizing designs with an innovative PCIe®/NVMe™ form factor for removable and embedded storage applications.



PCIe is a registered trademark of PCI-SIG. NVMe is a trademark of NVM Express, Inc. XFMEXPRESS is a trademark of KIOXIA Corporation.

Düsseldorf, Allemagne, le 14 juin 2022 - [KIOXIA Europe GmbH](#) a annoncé aujourd'hui l'échantillonnage du premier^[1] dispositif de stockage amovible NVMe à connexion PCIe conforme à la norme XFM Ver.1.0 du secteur, avec des capacités de 256 Go et 512 Go : le XFMEXPRESS XT2. Avec ses nouveaux facteur d'encombrement et connecteur XT2, le dispositif de stockage

KIOXIA

standard XFM Ver.1.0 offre une combinaison inégalée de fonctionnalités conçues pour révolutionner les PC ultramobiles, les dispositifs IoT et diverses applications embarquées.

Introduit pour la première fois en août 2019, puis proposé au sous-comité JEDEC pour les spécifications électriques et les protocoles de commande, le KIOXIA XFMEXPRESS XT2 est un nouveau facteur d'encombrement pour les dispositifs PCIe/NVMe. La technologie XFMEXPRESS, qui offre une remarquable combinaison entre petite taille, vitesse et facilité d'entretien, a été développée pour améliorer les applications mobiles et embarquées de la prochaine génération. Le KIOXIA XFMEXPRESS XT2 est le premier produit à répondre aux spécifications de la norme JEDEC.

Caractéristiques clés et principaux avantages du KIOXIA XFMEXPRESS XT2 :

- **une facilité d'entretien qui change tout**

Le XFMEXPRESS XT2 constitue une nouvelle catégorie de petits dispositifs de stockage faciles à entretenir ou à mettre à niveau. En associant un boîtier robuste et compact, une fonctionnalité de stockage amovible et la flexibilité, le XFMEXPRESS XT2 contribue à réduire les obstacles techniques ainsi que les contraintes de conception.

- **une empreinte adaptée aux mobiles**

La petite taille et le profil bas (14 mm x 18 mm x 1,4 mm) du facteur d'encombrement du DISPOSITIF JEDEC XFM Ver.1.0 offrent une empreinte de 252 mm^[2], ce qui permet d'optimiser l'espace de montage pour les appareils hôtes ultracompacts, sans devoir sacrifier les performances ou la facilité d'entretien. Avec cette hauteur z minimisée, le facteur d'encombrement du XFMEXPRESS XT2 est excellent pour les ordinateurs portables fins et légers, et offre de nouvelles possibilités de conception pour les applications et les systèmes de la prochaine génération.

- **Interface**

Conçu pour la vitesse, le XFMEXPRESS XT2 exploite une interface PCIe 4.0 x 2 voies, NVMe 1.4b. Les performances de pointe^[3] du XFMEXPRESS XT2 et son facteur d'encombrement durable constituent une alternative convaincante à d'autres facteurs d'encombrement de SSD (tels que M.2), garantissant ainsi de meilleures expériences informatiques et de divertissement.

KIOXIA

« Consciente du besoin d'une nouvelle catégorie de stockage amovible, KIOXIA, inventrice de la mémoire flash, a mis à profit sa vaste expérience de la conception de mémoires à boîtier unique pour développer le XFMEXPRESS XT2 », explique Axel Stoermann, vice-président du marketing et de l'ingénierie des mémoires chez KIOXIA Europe GmbH. « Nous prévoyons d'innover et de montrer la voie à suivre en proposant à l'avenir d'autres solutions de stockage révolutionnaires pour répondre à des défis de conception complexes. »

KIOXIA présentera sa solution XT2 en direct à l'occasion d'[Embedded World 2022](#) à Nuremberg, en Allemagne, du 21 au 23 juin, dans la halle 3A, au stand #3A-117, ainsi que lors du [Flash Memory Summit 2022](#), du 2 au 4 août, au Santa Clara Convention Center, en Californie.

###

Notes

[1] À partir du 14 juin 2022, source : étude KIOXIA

[2] 22,2 mm x 17,75 mm x 2,2 mm, disque et connecteur

[3] À partir de juin 2022, par rapport aux autres facteurs d'encombrement PCIe NVMe, y compris M.2 et microSD

Les marques déposées, services et/ou noms de sociétés suivants – NVM Express, NVMe, PCI Express, PCIe – ne sont ni déposés, ni enregistrés, ni créés, ni détenus par KIOXIA Europe GmbH ou par des sociétés affiliées du groupe KIOXIA. Cependant, ils peuvent être déposés, enregistrés, créés et/ou détenus par des tiers dans diverses juridictions et donc protégés contre une utilisation non autorisée.

Les noms de sociétés, de produits et de services mentionnés ici peuvent être des marques de leurs détenteurs respectifs.

À propos de KIOXIA Europe GmbH

KIOXIA Europe GmbH (auparavant Toshiba Memory Europe GmbH) est la filiale européenne de KIOXIA Corporation, leader mondial en matière de production de mémoires flash et de disques SSD. De l'invention de la mémoire flash à la technologie révolutionnaire BiCS FLASH d'aujourd'hui, KIOXIA reste pionnière dans le domaine des solutions et services de stockage de pointe enrichissant la vie de chacune et chacun, et élargissant les horizons de la société. L'innovante technologie de mémoire flash 3D de KIOXIA,

KIOXIA

BiCS FLASH, façonne l'avenir du stockage dans des applications à haute densité, notamment les smartphones, les PC, les disques SSD, les centres de données et l'automobile.

Visitez notre [site Web KIOXIA](#)

Coordonnées pour la publication :

KIOXIA Europe GmbH, Hansaallee 181, 40549 Düsseldorf, Allemagne

Tél. : +49 (0) 211 368 77-0

Adresse e-mail : KIE-support@kioxia.com

Coordonnées pour des requêtes éditoriales :

Lena Hoffmann, KIOXIA Europe GmbH

Tél. : +49 (0) 211 36877 382

Adresse e-mail : lena1.hoffmann@kioxia.com

Publié par :

Birgit Schöniger, Publitek

Tél. : +49 (0) 4181 968098-13

Adresse e-mail : birgit.schoeniger@publitek.com

Site Web : www.publitek.com

Réf. KIE078/A_FR